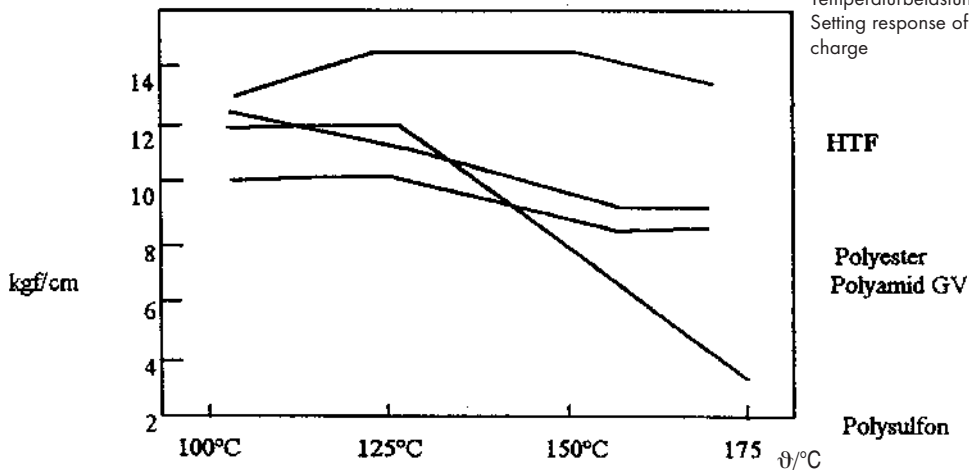


## Isolierbuchsen aus HTF Insulating bushings of HTF material

Gute Kühlung ist wichtig für die Belastbarkeit und Lebensdauer von Halbleitern. Viele Isolierbuchsen aber setzen die Lebensdauer von Halbleitern herab, weil ihr Kunststoff kriecht, d.h. sich unter Druck und Wärme wie eine zähe Flüssigkeit verhält, die ausweicht und die Andruckkraft verringert. Durch einen geringen Andruck wird die Wärmeableitung reduziert und der Halbleiter wird noch heißer. Ein vernichtender Rückkopplungseffekt, der den Halbleiter zerstört. Unsere Isolierbuchsen aus HTF haben diesen Effekt nicht. Sie sind bis 200° C formstabil und werden deshalb von namhaften Halbleiterherstellern empfohlen.

Good cooling is important for load and lifetime of semiconductors. Many bushings decrease the lifetime of semiconductors because the plastic material creeps away and acts under pressure and heat like a viscous liquid flowing off and reduces the pressure. The contact pressure is diminished and therefore also the thermal flux, the semiconductor will heat up even more. A terrible feedback, which will destroy the semiconductor. Our bushings of HTF do not have this effect. They stay undistorted up to 200° C and are recommended by all wellknown manufacturers of semiconductors.

Drehmoment um die Schraube 1/8 Umdrehung festzuziehen/  
Necessary torque to tighten the screw by 1/8 turn

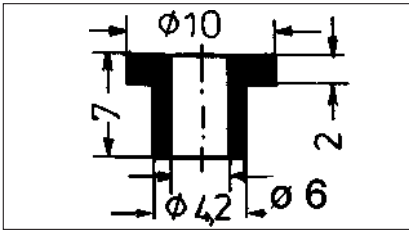


Setzungsverhalten der Isolierbuchse bei Temperaturbelastung/  
Setting response of the bushing at thermal charge

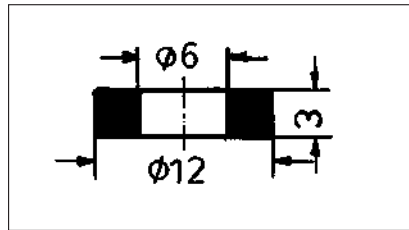
Wärmeformbeständigkeit/Thermal deformation	ASTM	
bei/at 18.0 kg/cm <sup>2</sup>	D 648	202° C
Brennbarkeit/Combustibility	D 635	nicht brennbar/ not inflammable/
Spez. Gewicht/Spec. gravity	D 792	1.4
Dielektrizitätskonstante/Dielectric constant		
50 Hz-10 <sup>6</sup> Hz	D 150	3.5
Verlustfaktor/Loss factor/	50 Hz	D 150
	10 <sup>3</sup> Hz	
	10 <sup>6</sup> Hz	
Spez. Widerstand/Resistivity	D 257	10 <sup>17</sup> Ω/cm
bei/at 175° C		2 x 10 <sup>10</sup> Ω/cm
Zugmodul/Traction module	D 638	2400 kg/cm <sup>2</sup>
Biegemodul/ Bending module	D 790	2500 kg/cm <sup>2</sup>
Izod-Schlagzähigkeit/Izod-impact strength	D 256	3.4 cm Kg/cm <sup>2</sup>
Rockwell-Härte/Rockwell-Hardness	D 785	M 88
Wasseraufnahme 24h/Water absorption 24h	D 570	0.5 %
Sättigung/Saturation		2 %

Alle Datenangaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich.  
All data given to our best knowledge but without obligation.

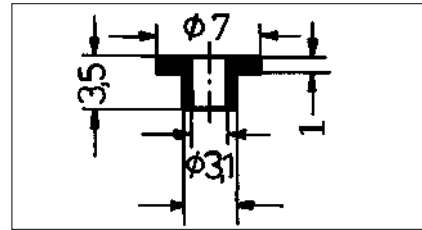
IB 3 (Teflon)



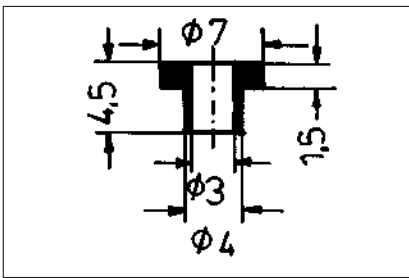
IB 3 Ring (Teflon)



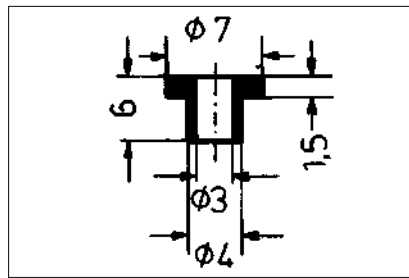
IB 7 (HTF)



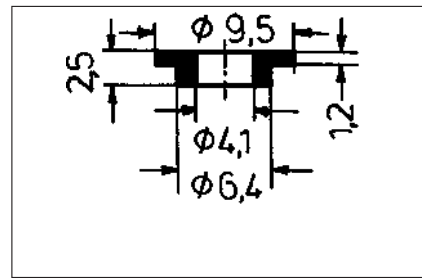
IB 8-3 (HTF)  
IB 4-3 (Teflon)



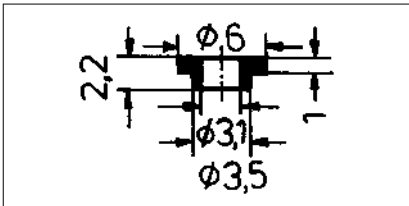
IB 8-4,5 (HTF)



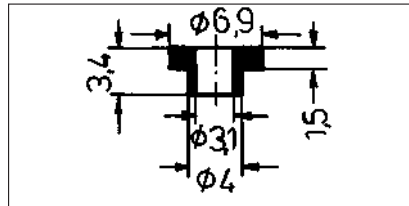
IB 9 (HTF)



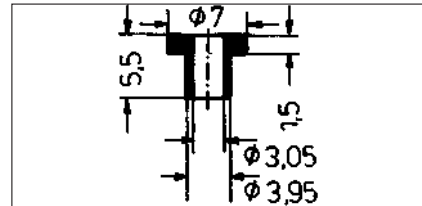
IB 10 (HTF)



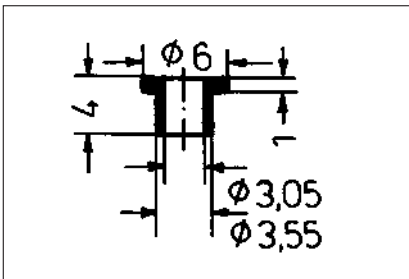
IB 11 (HTF)



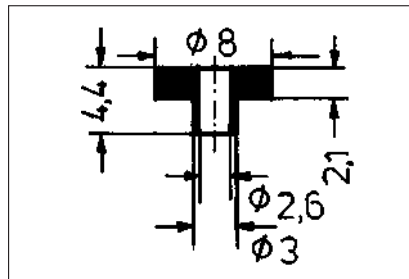
IB 13 (HTF)



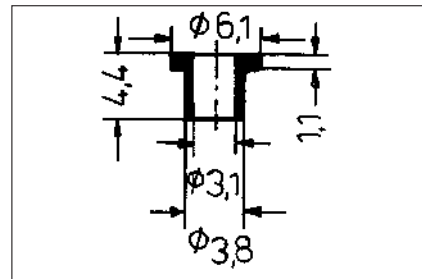
IB 14 (HTF)



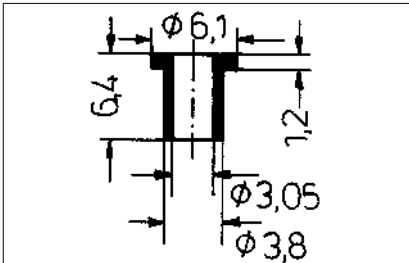
IB 18 (HTF)



IB 21 (HTF/GF)



IB 22 (HTF/GF)



IB 23 (HTF)

